

Metronelec ST系列可焊性测试仪

创建于1975年的Metronelec长期致力于为电子行业高精度的可焊性测试仪。其同时是IEC(欧洲电工学会), IPC(美国电子电路与电子互连行业协会), NF(法国标准协会)会员, 并参与制定可焊性相关标准. Metronelec可焊性测试仪可以对包括各种类型的贴片器件, 插件器件, 印刷线路板在内的各种样品进行测试. 其先进的测试技术, 最大程度地避免了之前非直接测量以及认为因素的影响. 其广泛应用于来料检验, 工艺部门以及相关实验室.

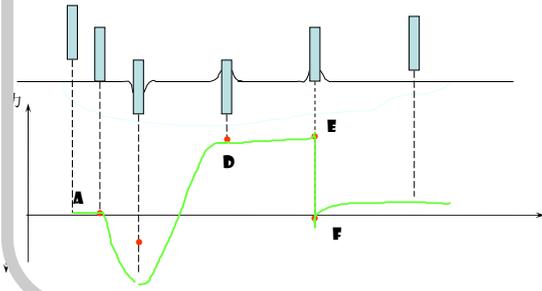
Metronelec ST系列可焊性测试仪提高精度的测试。其通过消除由于可焊性而造成的产品质量问题, 从而大幅提高产品产量和良品率。同时对于助焊剂的选择大有裨益之外, 还使得评估对环境更友善的焊料变得可能. 同时为了满足无铅测试的要求, 焊锡槽的温度可以设定在260度以上. 用户可在Metronelec ST系列全自动可焊性测试仪轻易更换锡球或者锡槽模块, 软件内建元器件库, 用户只需选择相关的器件, 就可以调用已有的测试参数。



兼容标准

IEC 60068-2-54和IEC 60068-2-69
MIL-STD-883 METHOD 2022
IPC J-STD-002
IPC J-STD-003
EIA/JET-7401

关于润湿平衡法



物理学家Thmas Young和Pierre Simon LAPLACE发现了所谓的表面张力现象，其也是我们进行可焊性测试的理论基础。

测试过程如左图

在位置A ($T=0$),样品开始浸润. 位置B, 样品浸没的底端, 此时只有样品只是受到浮力的作用. 从位置C开始, 由于润湿力的作用, 液面开始向上爬升. 样品受到润湿力向下的作用. 位置 D 所有的力达到平衡点 位置 E,测量结束

产品特性

- 全自动产品定位
- 定量分析, 自动调用内建的IPC, IEC, MIL, FR标准判断可焊性
- 用户可自建标准
- 全自动测试, 高重复精度
- 可选择锡球进行润湿平衡法测试
- 针对不同器件可选择相应的夹具
- 可进行0201, 01005器件的测量
- 全自动表面氧化物清除
- 可同时输出润湿力和角度
- 软件多种语言自动切换: 中文, 英文, 法文, 德文...

ST78 技术指标

传感器	线性度0.1%, 分辨率1mg
浸润深度	0.1-9mm之间可以调整
浸润速度	1-50mm/s可以调整, 每步1mm
退出速度	1-50mm/s可以调整, 每步1mm
温度范围	室温-450度
测试模式	锡槽
重量	28kg
电源	110V/220V可选

ST88 技术指标

传感器	线性度0.1%, 分辨率1mg
浸润深度	0.02-25mm之间可以调整, 每步0.01mm
浸润速度	1-50mm/s可以调整, 每步1mm
退出速度	1-50mm/s可以调整, 每步1mm
温度范围	室温-450度
测试模式	锡球/锡槽
氮气保护	<100ppm O_2
锡球测试	1, 2, 4mm锡球
重量	50kg
电源	110V/220V可选

联系我们

